

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2021年11月25日(25.11.2021)



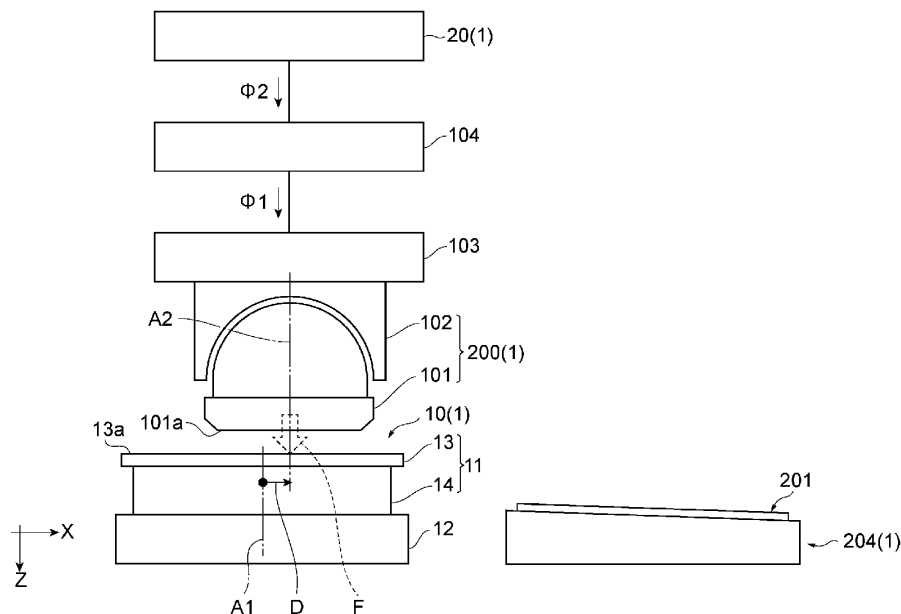
(10) 国際公開番号

WO 2021/235269 A1

- (51) 国際特許分類:  
H01L 21/60 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/017854
- (22) 国際出願日: 2021年5月11日(11.05.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2020-087251 2020年5月19日(19.05.2020) JP
- (71) 出願人: 株式会社新川 (SHINKAWA LTD.) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: アレクサンダー ジャンギーロフ (ALEXANDER Dzhangirov); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP). 野口 勇一郎 (NOGUCHI Yuichiro); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内 2 丁目 1 番 1 号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9 階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

(54) Title: BONDING DEVICE AND ADJUSTMENT METHOD FOR BONDING HEAD

(54) 発明の名称: ボンディング装置及びボンディングヘッド調整方法



(57) Abstract: A bonding device 1 comprises a chip holding part 101 that disposes a chip part 202 onto a substrate 201 that has been placed on a substrate stage 204. The bonding device 1 adjusts the inclination of a chip holding surface 101a that releasably holds the chip part 202. The bonding device 1 comprises: an adjustment controller 20 which stores inclination information pertaining to inclination respectively for locations on a stage main surface 204a having the substrate 201 placed thereon; and a conforming jig 10 which has a conforming surface 13a onto which the chip holding surface 101a is

[続葉有]

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,  
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,  
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,  
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,  
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,  
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,  
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告(条約第21条(3))

pressed, and in which the inclination of the conforming surface 13a can be changed such that the inclination of the chip holding surface 101a corresponds to the inclination indicated by the inclination information.

(57) 要約: ボンディング装置1は、基板ステージ204に載置された基板201に対してチップ部品202を配置するチップ保持部101を備える。ボンディング装置1は、チップ部品202を着脱可能に保持するチップ保持面101aの傾きを調整する。ボンディング装置1は、基板201が載置されたステージ主面204aの場所ごとの傾きに関する傾き情報を保持する調整コントローラ20と、チップ保持面101aが押し付けられる倣い面13aを有し、チップ保持面101aの傾きが傾き情報に示される傾きに対応するように倣い面13aの傾きを変更可能な倣い治具10と、を備える。